

WEST

☐ Generate Collection☐ Print

L2: Entry 1 of 2

File: JPAB

Sep 28, 2001

PUB-NO: JP02001267241A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2001267241 A

TITLE: METHOD AND APPARATUS FOR CLEANING, AND METHOD AND APPARATUS FOR ETCHING

PUBN-DATE: September 28, 2001

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SONOBE, ATSUSHI

KURODA, YOSHIKUNI

REGIS, JIRUSU

INO, MINORU

KIMURA, TAKAKO

NISHIKAWA, YUKINOBU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

L'AIR LIQUIDE

APPL-NO: JP2000066777

APPL-DATE: March 10, 2000

INT-CL (IPC): H01 L 21/205; C23 C 16/44; H01 L 21/3065; H01 L 21/304

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve safety, cost and flexibility or the like of a method and an apparatus for cleaning and of a method and an apparatus for etching in a semiconductor processing system.

SOLUTION: A cleaning apparatus 30 is connected to a processing chamber 12 of a CVD system 10 for silicon. The cleaning apparatus 30 has first, second and third gas sources 32, 34, 36, from which chlorine gas, fluorine gas and an inert gas are introduced through MFC 38a, 38b, 38c, respectively, wherein each flow rate is controlled under a mutually independent condition. These gases join in a piping member 42, being mixed to form a mixed gas. The mixed gas is led to a heated reactor 44, for example, a heat exchanger, to generate a generated gas containing chlorine fluoride gases such as ClF3 and the like by the reaction between the chlorine gas and the fluorine gas. The generated gas is fed to the inside of the processing chamber 12 through a cooling unit 4, an analyzing unit 48 and a buffer member 54.

COPYRIGHT: (C) 2001, JPO

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-267241

(P2001-267241A)

(43) 公開日 平成13年9月28日 (2001.9.28)

(51) Int. Cl.	識別記号	F I	ターミナル (参考)
H 0 1 L 21/205		H 0 1 L 21/205	4 K 0 3 0
C 2 3 C 16/44		C 2 3 C 16/44	J 5 F 0 0 4
H 0 1 L 21/3065		H 0 1 L 21/304	6 4 5 Z 5 F 0 4 5
21/304	6 4 5	21/302	F

審査請求 未請求 請求項の数 9 O L (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願2000-66777 (P2000-66777)

(22) 出願日 平成12年3月10日 (2000.3.10)

(71) 出願人 591036572

レール・リキード・ソシエテ・アノニム・
 プール・レテュード・エ・レクスプロワタ
 シオン・デ・プロセデ・ジョルジュ・クロ
 ード

フランス国、75321 バリ・セデクス 07、
 カイ・ドルセイ 75

(72) 発明者 園部 淳

茨城県つくば市花畑2-11-2 ソリオ花
 畑305号

(74) 代理人 100058479

弁理士 鈴江 武彦 (外4名)

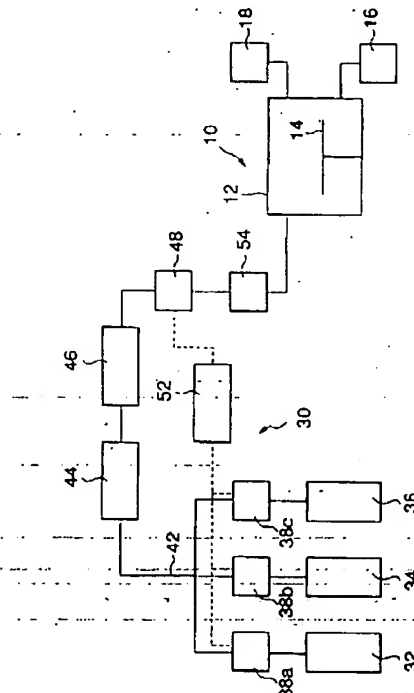
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 クリーニング方法及び装置並びにエッチング方法及び装置

(57) 【要約】

【課題】半導体処理システムにおけるクリーニング方法及び装置並びにエッチング方法及び装置の安全性、コスト、柔軟性等を改良する。

【解決手段】シリコンのCVD装置10の処理室12にクリーニング装置30が接続される。クリーニング装置30は第1、第2、及び第3ガス源32、34、36を有し、これ等から、塩素ガス、フッ素ガス、及び不活性ガスが、夫々MFC38a、38b、38cを通して、流量が互いに独立して制御された状態で導入される。これ等のガスは、配管部42で合流して混合され、混合ガスが形成される。混合ガスは、加熱反応器44例えば熱交換器に通され、塩素ガスとフッ素ガスとの反応によりC1F3ガス等の弗化塩素ガスを含む生成ガスが生成される。生成ガスは、冷却器46、分析器48、バッファ部54を通して、処理室12内に供給される。



merit gju

【特許請求の範囲】

【請求項1】半導体処理システムの処理室内に堆積した、Si、Mo、Ta、W、SiO_x、SiN_x、SiC、SiGe、TaSix、TaO_x、WSix、TiC、TiN、TiW、BN、ITOからなる群から選択された物質を含有する副生成物を除去するクリーニング方法であって、

第1及び第2ガス源から夫々独立してフッ素以外の第1ハロゲンガスとフッ素ガスを導入すると共に、第3ガス源から選択的に不活性ガスを導入し、これ等のガスを混合して混合ガスを形成する工程と、

前記混合ガスを加熱反応器に通して前記第1ハロゲンガスと前記フッ素ガスとが反応する温度に加熱することにより、ハロゲン間フッ素化合物ガスを含む生成ガスを生成しながら、前記生成ガスを前記処理室内に供給する工程と、を具備することを特徴とするクリーニング方法。

【請求項2】前記混合ガスにおける前記第1ハロゲンガス、フッ素ガス、及び不活性ガスの容積比が10～90：10～90：0～90に設定されることを特徴とする請求項1に記載のクリーニング方法。

【請求項3】前記第1ハロゲンガスは塩素ガスであり、前記加熱反応器による前記混合ガスの加熱温度は250℃～350℃であることを特徴とする請求項1または2に記載のクリーニング方法。

【請求項4】前記第1不活性ガスはヘリウムガスであることを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載のクリーニング方法。

【請求項5】半導体処理システムの処理室内に堆積した、Si、Mo、Ta、W、SiO_x、SiN_x、SiC、SiGe、TaSix、TaO_x、WSix、TiC、TiN、TiW、BN、ITOからなる群から選択された物質を含有する副生成物を除去するクリーニング装置であって、

第1及び第2ガス源から夫々独立してフッ素以外の第1ハロゲンガスとフッ素ガスを導入すると共に、第3ガス源から選択的に不活性ガスを導入し、これ等のガスを混合して混合ガスを形成する上流部と、

前記混合ガスを加熱反応器に通して前記第1ハロゲンガスと前記フッ素ガスとが反応する温度に加熱することにより、ハロゲン間フッ素化合物ガスを含む生成ガスを生成しながら、前記生成ガスを前記処理室内に供給する下流部と、を具備することを特徴とするクリーニング装置。

【請求項6】前記上流部は、前記第1ハロゲンガス、フッ素ガス、及び不活性ガスの流量を互いに独立して制御することにより、前記混合ガスにおける前記第1ハロゲンガス、フッ素ガス、及び不活性ガスの容積比を変更するコントローラを具備することを特徴とする請求項5に記載のクリーニング装置。

【請求項7】被処理体上の、Si、SiPOS、Ta、

TaSixからなる群から選択された物質から実質的になる第1膜をエッチングする、半導体処理システムのエッチング方法であって、

第1及び第2ガス源から夫々独立してフッ素以外の第1ハロゲンガスとフッ素ガスを導入すると共に、第3ガス源から選択的に不活性ガスを導入し、これ等のガスを混合して混合ガスを形成する工程と、

前記混合ガスを加熱反応器に通して前記第1ハロゲンガスと前記フッ素ガスとが反応する温度に加熱することにより、ハロゲン間フッ素化合物ガスを含む生成ガスを生成しながら、前記生成ガスを前記処理室内に供給する工程と、を具備することを特徴とするエッチング方法。

【請求項8】前記被処理体上に、SiO₂、SiN_x、TaO_x、フォトレジストからなる群から選択された物質から実質的になる第2膜が存在し、前記エッチング方法は、前記1膜を前記第2膜に対して選択的にエッチングするものであることを特徴とする請求項7に記載のエッチング方法。

【請求項9】被処理体上の、Si、SiPOS、Ta、TaSixからなる群から選択された物質から実質的になる第1膜をエッチングする、半導体処理システムのエッチング装置であって、

前記被処理体を収容する処理室と、

第1及び第2ガス源から夫々独立してフッ素以外の第1ハロゲンガスとフッ素ガスを導入すると共に、第3ガス源から選択的に不活性ガスを導入し、これ等のガスを混合して混合ガスを形成する上流部と、

前記混合ガスを加熱反応器に通して前記第1ハロゲンガスと前記フッ素ガスとが反応する温度に加熱することにより、ハロゲン間フッ素化合物ガスを含む生成ガスを生成しながら、前記生成ガスを前記処理室内に供給する下流部と、を具備することを特徴とするエッチング装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明はハロゲン間フッ素化合物ガスを利用する、半導体処理システムにおけるクリーニング方法及び装置並びにエッチング方法及び装置に関する。なお、ここで、半導体処理とは、半導体ウエハやLCD基板等の被処理体上に半導体層、絶縁層、導電層等を所定のパターンで形成することにより、該被処理体上に半導体デバイスや、半導体デバイスに接続される配線、電極等を含む構造物を製造するために実施される種々の処理を意味する。

【0002】

【従来の技術】半導体処理システムにおいて、ClF₃等のハロゲン間フッ素化合物ガスが、処理室や排気管系統のクリーニングや、被処理体のエッチングに利用されている。例えば、ClF₃（三弗化塩素）ガスは、シリコン（Si）、ポリシリコン、アモルファスシリコン、酸化シリコン（SiO₂）、窒化シリコン（Si

3 N₄)、タングステンシリサイド(WSi₂)、タングステンチタン(TiW)、酸化タンタル(Ta₂O₅)、シリコンゲルマニウム(SiGe)等の膜を形成するためのCVD装置のクリーニングガスとして使用されている。CIF₃ガスは、プラズマを使用しないで、しかも場合によっては常温でも反応する性質があるという利点を有する。

【0003】CIF₃ガスは、金属製ポンペに高純度の液化ガスとして充填され、ユーザーサイトへ提供される。ユーザーサイトでは、ポンペからCIF₃の気相部が取出され、その時のポンペの温度における蒸気圧或いはそれ以下に減圧され、各半導体製造装置に送られる。

【0004】CIF₃は沸点が12℃と低いため、特に大流量でCIF₃ガスを流す必要がある場合、必要なガス量を得るため及び配管途中での再液化を防ぐために、ポンペ及び供給配管系の温度コントロールを精密に行う必要がある。しかしながら、CIF₃は非常に腐食性及び酸化力が強く、特に液相状態における反応性は極めて高い。このため、材料の点からポンペや配管の加熱に限界があり、また実用面でも、ポンペ及び配管の加熱は好ましくない。また、欧米では、このような反応性の高い液化CIF₃ガスの貯蔵や輸送に関して厳しい規制があり、非常に望ましいクリーニングガスでありながら、その適用範囲が限られている。

【0005】また、CIF₃をクリーニングガスとして使用する場合、それほど高い純度は必要とされない。このため、ユーザー側で必要とされるCIF₃の純度とその製造コストとが見合っていない場合がある。また、処理によっては、処理ガスをCIF₃のみから構成するより、異なる成分、例えばCIF₃やCIF₅を混入させた方がよい場合がある。更に、処理によっては、CIF₃或いはCIF₅を主成分として使用したい場合もある。このように、処理に応じたガス成分の調整を行いたい場合、現状では、別途に処理ガスの調製工程を加える等の手続が必要となる。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、かかる従来技術の問題点に鑑みてなされたものであり、ハロゲン間フッ素化合物ガスを利用する、半導体処理システムにおけるクリーニング方法及び装置並びにエッチング方法及び装置において、安全性、コスト、柔軟性等を改良することを目的とする。

【0007】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成する本発明は、オンサイトで且つオンデマンドでハロゲン間フッ素化合物ガスを生成且つ供給することを基本的な特徴とする。ここで、オンサイトとは、ハロゲン間フッ素化合物ガスを生成する機構が、半導体処理システムの主処理機構と組合わされることを意味する。また、オンデマンドとは、主処理機構側からの要求に応じたタイミングで

且つ必要とされる成分調整を伴って処理ガスが供給可能となることを意味する。

【0008】本発明の第1の視点は、半導体処理システムの処理室内に堆積した、Si、Mo、Ta、W、SiO_x、SiN_x、SiC、SiGe、TaSi_x、TaO_x、WSi_x、TiC、TiN、TiW、BN、ITOからなる群から選択された物質を含有する副生成物を除去するクリーニング方法であって、第1及び第2ガス源から夫々独立してフッ素以外の第1ハロゲンガスとフッ素ガスとを導入すると共に、第3ガス源から選択的に不活性ガスを導入し、これ等のガスを混合して混合ガスを形成する工程と、前記混合ガスを加熱反応器に通して前記第1ハロゲンガスと前記フッ素ガスとが反応する温度に加熱することにより、ハロゲン間フッ素化合物ガスを生成しながら、前記生成ガスを前記処理室内に供給する工程と、を具備することを特徴とする。

【0009】本発明の第2の視点は、第1の視点の方法において、前記混合ガスにおける前記第1ハロゲンガス、フッ素ガス、及び不活性ガスの容積比が10～90：10～90：0～90に設定されることを特徴とする。

【0010】本発明の第3の視点は、第1または第2の視点の方法において、前記第1ハロゲンガスは塩素ガスであり、前記加熱反応器による前記混合ガスの加熱温度は250℃～350℃であることを特徴とする。

【0011】本発明の第4の視点は、第1乃至第3のいずれかの視点の方法において、前記第1不活性ガスはヘリウムガスであることを特徴とする。

【0012】本発明の第5の視点は、半導体処理システムの処理室内に堆積した、Si、Mo、Ta、W、SiO_x、SiN_x、SiC、SiGe、TaSi_x、TaO_x、WSi_x、TiC、TiN、TiW、BN、ITOからなる群から選択された物質を含有する副生成物を除去するクリーニング装置であって、第1及び第2ガス源から夫々独立してフッ素以外の第1ハロゲンガスとフッ素ガスとを導入すると共に、第3ガス源から選択的に不活性ガスを導入し、これ等のガスを混合して混合ガスを形成する上流部と、前記混合ガスを加熱反応器に通して前記第1ハロゲンガスと前記フッ素ガスとが反応する温度に加熱することにより、ハロゲン間フッ素化合物ガスを生成しながら、前記生成ガスを前記処理室内に供給する下流部と、を具備することを特徴とする。

【0013】本発明の第6の視点は、第5の視点の装置において、前記上流部は、前記第1ハロゲンガス、フッ素ガス、及び不活性ガスの流量を互いに独立して制御することにより、前記混合ガスにおける前記第1ハロゲンガス、フッ素ガス、及び不活性ガスの容積比を変更するコントローラを具備することを特徴とする。

【0014】本発明の第7の視点は、被処理体上の、Si、SiPOS、Ta、TaSixからなる群から選択された物質から実質的になる第1膜をエッチングする、半導体処理システムのエッチング方法であって、第1及び第2ガス源から夫々独立してフッ素以外の第1ハロゲンガスとフッ素ガスを導入すると共に、第3ガス源から選択的に不活性ガスを導入し、これ等のガスを混合して混合ガスを形成する工程と、前記混合ガスを加熱反応器に通して前記第1ハロゲンガスと前記フッ素ガスとが反応する温度に加熱することにより、ハロゲン間フッ素化合物ガスを含む生成ガスを生成しながら、前記生成ガスを前記処理室内に供給する工程と、を具備することを特徴とする。

【0015】本発明の第8の視点は、第7の視点の方法において、前記被処理体上に、 SiO_2 、 $SiNx$ 、 TaO_x 、フォトレジストからなる群から選択された物質から実質的になる第2膜が存在し、前記エッチング方法は、前記1膜を前記第2膜に対して選択的にエッチングするものであることを特徴とする。

【0016】本発明の第9の視点は、被処理体上の、Si、SiPOS、Ta、TaSixからなる群から選択された物質から実質的になる第1膜をエッチングする、半導体処理システムのエッチング装置であって、前記被処理体を収容する処理室と、第1及び第2ガス源から夫々独立してフッ素以外の第1ハロゲンガスとフッ素ガスを導入すると共に、第3ガス源から選択的に不活性ガスを導入し、これ等のガスを混合して混合ガスを形成する上流部と、前記混合ガスを加熱反応器に通して前記第1ハロゲンガスと前記フッ素ガスとが反応する温度に加熱することにより、ハロゲン間フッ素化合物ガスを含む生成ガスを生成しながら、前記生成ガスを前記処理室内に供給する下流部と、を具備することを特徴とする。

【0017】

【発明の実施の形態】図1は本発明の実施の形態に係る、半導体処理システムの処理室内に堆積した副生成物を除去するクリーニング装置を示す概略図である。このクリーニング装置30は、例えば、半導体ウエハやLCD基板等の被処理基板上にシリコン膜を形成するためのCVD装置10に接続される。

【0018】CVD装置10は、被処理基板を収納するための処理室12を具備する。処理室12内には、被処理基板を載置するための載置台14が配設される。処理室12の下部には、内部を排気すると共に真空に設定するための排気系16が接続される。また、処理室12の上部には、 SiH_4 等の処理ガスを供給するための供給系18が接続される。

【0019】このようなCVD装置10においては、成膜処理を重ねるにつれ、処理室12の内壁や排気系16の配管の内壁にSiを主成分とする副生成物が堆積する。本発明に係るクリーニング装置30は、このような

副生成物を除去するために使用される。

【0020】クリーニング装置30は、塩素(Cl_2)ガス、フッ素(F_2)ガス、及び不活性ガスを夫々供給するための第1、第2、及び第3ガス源32、34、36を有する。塩素ガスのガス源32は液化ガスを充填したボンベからなる。塩素ガスは蒸気圧が高いため、比較的供給が容易である。一方、フッ素ガスのガス源34は、電気分解によりフッ素ガスを発生するガス発生器からなる。なお、フッ素ガスは高圧ガスとしてボンベで供給することも可能である。

【0021】不活性ガスは、希釈ガス或いはキャリアガスとして機能するもので、ヘリウム、アルゴン、窒素等のいずれかの不活性(inactive)ガスを使用することができる。しかし、ここでは、特に、後述する混合ガスの加熱を補助する観点から、熱伝導率の高いヘリウムガスを使用することが望ましい。なお、処理によっては、不活性ガスは使用しない場合もあり、即ち、不活性ガスは選択的に導入されることとなる。

【0022】第1、第2、及び第3ガス源32、34、36からの塩素ガス、フッ素ガス、及び不活性ガスは、夫々MFC(マスフローコントローラ)38a、38b、38cを通して、流量が互いに独立して制御された状態で導入される。このようにして夫々独立して導入された、塩素ガス、フッ素ガス、及び不活性ガスは、配管部42で合流して混合され、混合ガスが形成される。ここで、混合ガスにおける塩素ガス、フッ素ガス、及び不活性ガスの容積比は10:90、10:90:0、0:90:10に設定される。

【0023】このようにして形成された混合ガスは、加熱反応器44例えば熱交換器に通され、250℃~350℃に加熱される。これにより、塩素ガスとフッ素ガスとが反応し、 ClF_3 ガス等の非化塩素ガスを含む生成ガスが生成される。次に、 ClF_3 ガスを主成分とし、他の非化塩素ガス(ClF 、 ClF_2 等)、副生成物、未反応ガス等を含む生成ガスは、冷却器46により ClF_3 が液化しない室温程度まで冷却された後、 ClF_3 が液化しない程度の圧力で取出される。

【0024】冷却器46を出た生成ガスは、先ず、ハロゲン間フッ素化合物を測定する分析器48を通される。分析器48で得られた測定結果は、主コントローラ52にフィードバックされ、これに基づいてMFC38a、38b、38cが制御される。これにより、混合ガスにおける塩素ガス、フッ素ガス、及び不活性ガスの容積比が所定の値となるように調整される。

【0025】次に、生成ガスは、バッファ部54において、CVD装置10の処理室12の条件に適合するように流量及び圧力を調整された後、処理室12内に供給される。処理室12内に供給された生成ガス中の ClF_3 ガス等の非化塩素ガスは、処理室12の内壁や排気系16の配管の内壁に堆積したSiを主成分とする副生成

10

20

30

40

50

物と反応し、これを内壁から剥離させる。剥離した副生成物は、排気系16の作動による排気流によってCVD装置10外に排出される。

【0026】なお、この実施の形態では、クリーニング装置30は、シリコンのCVD装置10と組合わされて示されるが、弗化塩素ガスは、シリコン（ポリシリコン、アモルファスシリコンを含む）以外の物質を除去する場合にも有効である。具体的には、ここでいうシリコン以外の物質とは、Mo、Ta、W、SiO_x、SiN_x、SiC、SiGe、TaSi_x、TaO_x、WSi_x、TiC、TiN、TiW、BN、ITO（indium tin oxide）等である。従って、クリーニング装置30は、本来の処理により、上に列挙した物質からなる群から選択された物質を含有する副生成物が生成される、CVD装置やエッチング装置等のクリーニングに有効に適用することができる。

【0027】〔実験〕塩素ガス30SCCM、フッ素ガス100SCCM、及びヘリウムガス100SCCMからなる混合ガスを形成し、250℃～350℃に加熱したニッケル製の熱交換器からなる加熱反応器44に、系内圧力836Torrで連続的に流し続けた。その結果、加熱反応器44の出口付近で、C₂F₆の濃度が10%～30%、C₂F₆の収率が60%～80%の生成ガスが得られることが判明した。

【0028】図2は本発明の別の実施の形態に係る、半導体処理システムのエッチング装置を示す概略図である。このエッチング装置60は、例えば、半導体ウエハやLCD基板等の被処理基板上においてSi膜をSiO₂膜に対して優先的にエッチング（選択エッチング）するために使用される。

【0029】エッチング装置60は、被処理基板を収納するための処理室62を具備する。処理室62内には、被処理基板を載置するための載置台64が配設される。処理室62の下部には、内部を排気すると共に真空に設定するための排気系66が接続される。また、処理室62の上部には、エッチングガスを供給するための供給系70が接続される。エッチング装置60の供給系70は、図1図示のクリーニング装置30と同様な構成を有する。

【0030】即ち、供給系70は、塩素（Cl₂）ガス、フッ素（F₂）ガス、及び不活性ガスを夫々供給するための第1、第2、及び第3ガス源72、74、76を有する。第1、第2、及び第3ガス源72、74、76からの塩素ガス、フッ素ガス、及び不活性ガスは、夫々MFC（マスフローコントローラ）78a、78b、78cを通して、流量が互いに独立して制御された状態で導入される。このようにして夫々独立して導入された、塩素ガス、フッ素ガス、及び不活性ガスは、配管部82で合流して混合され、混合ガスが形成される。ここで、混合ガスにおける塩素ガス、フッ素ガス、及び不活

性ガスの容積比は10～90：10～90：0～90に設定される。

【0031】このようにして形成された混合ガスは、加熱反応器84例えば熱交換器に通され、250℃～350℃に加熱される。これにより、塩素ガスとフッ素ガスとが反応し、C₂F₆ガス等の弗化塩素ガスを含む生成ガスが生成される。次に、C₂F₆ガスを主成分とし、他の弗化塩素ガス（C₂F₄、C₂F₈等）、副生成物、未反応ガス等を含む生成ガスは、冷却器86によりC₂F₆が液化しない室温程度まで冷却された後、C₂F₆が液化しない程度の圧力で取出される。

【0032】冷却器86を出た生成ガスは、先ず、ハロゲン間フッ素化合物を測定する分析器88を通される。分析器88で得られた測定結果は、主コントローラ92にフィードバックされ、これに基づいてMFC78a、78b、78cが制御される。これにより、混合ガスにおける塩素ガス、フッ素ガス、及び不活性ガスの容積比が所定の値となるように調整される。

【0033】次に、生成ガスは、バッファ部94において、CVD装置10の処理室12の条件に適合するように、流量及び圧力を調整された後、処理室12内に供給される。処理室62内に供給された生成ガス中のC₂F₆ガス等の弗化塩素ガスは、被処理基板上においてSiO₂膜よりもSi膜と優先的に反応し、これをエッチングする。エッチング生成物は、排気系66の作動による排気流によってエッチング装置60外に排出される。

【0034】なお、この実施の形態では、エッチング装置60は、被処理基板上においてSi膜からなる第1膜をSiO₂膜からなる第2膜に対して選択エッチングするための装置として示されるが、弗化塩素ガスは、Si膜とSiO₂膜との組合わせ以外の物質の組合わせた選択エッチングにも有効である。具体的には、優先的にエッチングされる第1膜は、Si、SIPOS（semi-insulating polycrystalline silicon）、Ta、TaSi_xからなる群から選択された物質から実質的になることができる。また、優先的にエッチングされない第2膜は、SiO₂、SiN_x、TaO_x、フォトレジストからなる群から選択された物質から実質的になることができる。

【0035】上述のクリーニング装置30及びエッチング装置60においては、ユーザーサイトで、塩素ガス、フッ素ガス、及び不活性ガスをガス源として使用して、C₂F₆ガス等の弗化塩素ガスを生成且つ供給することができる。従って、C₂F₆ガス等の弗化塩素ガスを、液化ガスとしてボンベでユーザーサイトに提供する場合の操作上及び法的規制上の問題を解消することができる。特に、これ等の装置30、60によれば、混合ガスにおける塩素ガス、フッ素ガス、及び不活性ガスの容積比を、前述の範囲で任意の値に設定したり、混合ガスの加熱温度を前述の範囲で任意の値に設定することによ

り、生成ガスの組成を処理に応じて調整することができる。

【0036】更に、第1ガス源(32、72)のガスとして、塩素ガスに代え、別のハロゲンガス(フッ素以外)を使用することにより、別のタイプのハロゲン間フッ素化合物ガスを生成及び供給することが可能となる。例えば、第1ガス源32のガスとして、臭素(Br_2)ガスを使用すると、 BrF 、 BrF_3 、 BrF_5 の少なくとも1つを含む生成ガスを供給することができる。また、第1ガス源32のガスとして、ヨウ素(I_2)ガスを使用すると、 IF 、 IF_3 、 IF_5 、 IF_7 の少なくとも1つを含む生成ガスを供給することができる。

【0037】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、オンサイトで且つオンデマンドでハロゲン間フッ素化合物ガスを含む生成ガスを供給することができるため、半導体処理システムにおけるクリーニング方法及び装置並びにエッチング方法及び装置の安全性、コスト、柔軟性等を改良することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態に係る、半導体処理システムの処理室内に堆積した副生成物を除去するクリーニング装置を示す概略図。

【図2】本発明の別の実施の形態に係る、半導体処理システムのエッチング装置を示す概略図。

【符号の説明】

10…CVD装置

30…クリーニング装置

32、72…塩素ガス源

34、74…フッ素ガス源

36、76…不活性ガス源

38a～38c、78a～78c…MFC

42、82…配管部

44、84…加熱反応器

46、86…冷却器

48、88…分析器

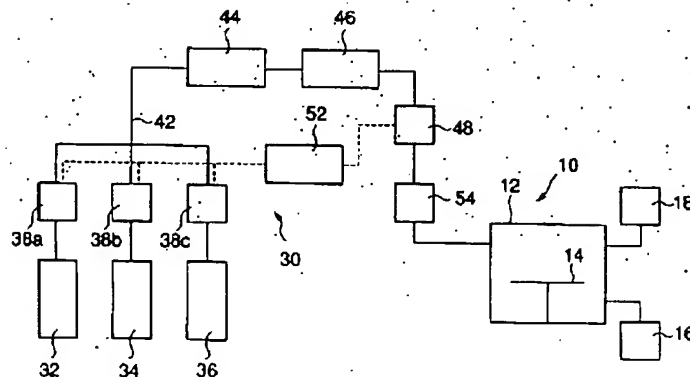
52、92…主コントローラ

54、94…バッファ部

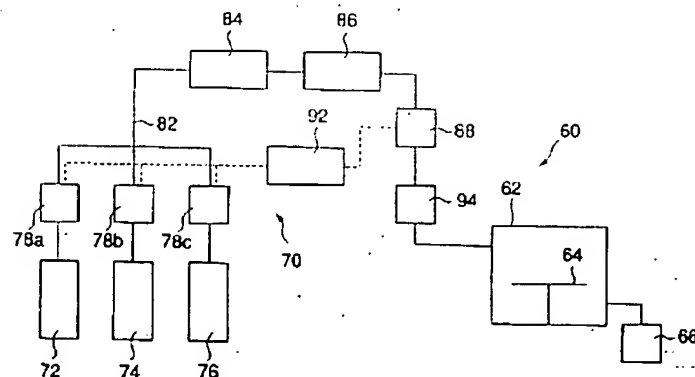
60…エッチング装置

20 70…供給系

【図1】



【図2】



フロントページの続き

(72)発明者 黒田 嘉邦
茨城県つくば市春日2-22-21 えのきマ
ンション208号

(72)発明者 レジス・ジルス
茨城県つくば市二の宮1-19-12 マノワ
ール二の宮 201号

(72)発明者 猪野 実
茨城県つくば市吉沼3497-3

(72)発明者 木村 孝子
茨城県稲敷郡阿見町荒川木郷 1338-28

(72)発明者 西川 幸伸
神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町547-205

Fターム(参考) 4K030 DA06

5F004 AA15 BC08 BD04 CA01 CA02

DA00 DA04 DA22 DB00 DB01

DB08 DB10 DB12 DB15 DB17

5F045 AB02 AC01 AC02 BB20 EB06

EE04 EE05 EE11 EE13 EE14

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[The technical field to which invention belongs] this invention relates to the cleaning method, the equipment, the etching method, and equipment using the fluorine compound gas between halogens in a semiconductor processing system. In addition, semiconductor processing means the various processings carried out in order to manufacture the structure containing the wiring connected to a semiconductor device and a semiconductor device on this processed object, an electrode, etc. here by forming a semiconductor layer, an insulating layer, a conductive layer, etc. by the predetermined pattern on processed objects, such as a semiconductor wafer and a LCD substrate.

[0002]

[Description of the Prior Art] a semiconductor processing system -- setting -- ClF_3 etc. -- the fluorine compound gas between halogens is used for a processing room, cleaning of an exhaust pipe system, and etching of a processed object. For example, ClF_3 gas (three chlorine fluorides) is used as cleaning gas of the CVD system for forming films, such as contest polysilicon [silicon (Si) and], an amorphous silicon, a silicon oxide (SiO_2), a silicon nitride (Si_3N_4), tungsten silicide (WSi_2), tungsten titanium (TiW), tantalum oxide (Ta_2O_5), and silicon germanium (SiGe). ClF_3 Gas has the advantage that there is a property to react also in ordinary temperature moreover, depending on the case without using plasma.

[0003] ClF_3 A metal bomb is filled up with gas as a liquefied gas of a high grade, and user SAITOHE offer is made. At a user site, it is a bomb to ClF_3 . The gaseous-phase section is taken out, less than [the vapor pressure in the temperature of the bomb at that time or it] decompresses, and it is sent to each semiconductor fabrication machines and equipment.

[0004] ClF_3 The boiling point is ClF_3 at a 12-degree-C and low sake, especially a large flow rate. When gas needs to be passed, in order to obtain required capacity, and in order to prevent the reliquefaction in the middle of piping, it is necessary to perform precisely the temperature control of a bomb and a charging-line system. However, ClF_3 Corrosive and oxidizing power are very strong, and the reactivity especially in a liquid phase state is very high. For this reason, a limitation is in heating of a bomb or piping from the point of material, and heating of a bomb and piping is not desirable in respect of practical use. Moreover, liquefaction ClF_3 with such reactivity high in Europe and America. There is severe regulation about storage and transportation of gas, and the scope is restricted though it is very desirable cleaning gas.

[0005] Moreover, ClF_3 When using it as cleaning gas, so high purity is not needed. For this reason, ClF_3 needed by the user side Purity and its manufacturing cost may not have balanced. moreover, processing -- a raw gas -- ClF_3 from -- a component which is different rather than it constitutes, for example, ClF, and ClF_5 Made it better [to mix]. Furthermore, depending on processing, they are ClF or ClF_5 . It is to use it as a principal component. Thus, in the present condition, procedure, such as adding, the manufacture process of a raw gas separately, is needed to adjust the gas constituents according to processing.

[0006]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] this invention is made in view of the trouble of this conventional technology, and aims at improving safety, cost, flexibility, etc. in the cleaning method, the equipment, the etching method, and equipment using the fluorine compound gas between halogens in a semiconductor processing system.

[0007]

[Means for Solving the Problem] this invention which attains the above-mentioned purpose is on site, and is characterized [fundamental] by generating and supplying the fluorine compound gas between halogens by on demand one. Here, the mechanism which generates the fluorine compound gas between halogens as it is on site means being combined with the main processor of a semiconductor processing system. Moreover, a raw gas means a bird clapper as supply being possible with the quality governing which on demand ones is the timing according to the demand from the main processor side, and is needed.

[0008] Deposited the 1st view of this invention on the processing interior of a room of a semiconductor processing system. Si, Mo, Ta, W, SiOx, SiNx, SiC, SiGe, TaSix, It is the cleaning method of removing the by-product containing the matter chosen from the group which consists of TaOx, WSix, and TiC, TiN, TiW, BN and ITO. the [the 1st and], while introducing the 1st halogen gas and fluorine gas other than a fluorine respectively independently of the source of 2 gas By heating to the process which introduces inert gas alternatively from the source of the 3rd gas, mixes gas, such as this, and forms mixed gas, and the temperature to which the aforementioned 1st halogen gas and the aforementioned fluorine gas react to a pyrogenetic-reaction machine through the aforementioned mixed gas It is characterized by providing the process which supplies the aforementioned generation gas to the aforementioned processing interior of a room, generating the generation gas containing the fluorine compound gas between halogens.

[0009] The 2nd view of this invention is characterized by setting the volume ratio of the aforementioned 1st halogen gas in the aforementioned mixed gas, fluorine gas, and inert gas as 10-90:10-90:0-90 in the method of the 1st view.

[0010] In the method of the 1st or 2nd view, the aforementioned 1st halogen gas of the 3rd view of this invention is chlorine gas, and it is characterized by the heating temperature of the aforementioned mixed gas with the aforementioned pyrogenetic-reaction machine being 250 degrees C - 350 degrees C.

[0011] The 4th view of this invention is characterized by the aforementioned ***** being gaseous helium in the method of the view of either the 1st or the 3rd.

[0012] Deposited the 5th view of this invention on the processing interior of a room of a semiconductor processing system. Si, Mo, Ta, W, SiOx, SiNx, SiC, SiGe, TaSix, It is cleaning equipment from which the by-product containing the matter chosen from the group which consists of TaOx, WSix, and TiC, TiN, TiW, BN and ITO is removed. the [the 1st and], while introducing the 1st halogen gas and fluorine gas other than a fluorine respectively independently of the source of 2 gas By heating to the upper section which introduces inert gas alternatively from the source of the 3rd gas, mixes gas, such as this, and forms mixed gas, and the temperature to which the aforementioned 1st halogen gas and the aforementioned fluorine gas react to a pyrogenetic-reaction machine through the aforementioned mixed gas It is characterized by providing the downstream which supplies the aforementioned generation gas to the aforementioned processing interior of a room, generating the generation gas containing the fluorine compound gas between halogens.

[0013] The 6th view of this invention is characterized by the aforementioned upper section possessing the controller which changes the volume ratio of the aforementioned 1st halogen gas in the aforementioned mixed gas, fluorine gas, and inert gas by controlling independently mutually the flow rate of the aforementioned 1st halogen gas, fluorine gas, and inert gas in the equipment of the 5th view.

[0014] The 7th view of this invention *****s the 1st film which becomes substantial from the matter chosen from the group which consists of Si on a processed object, SiPOS, Ta, and TaSix. the etching method of a semiconductor processing system -- it is -- the [the 1st and], while introducing the 1st halogen gas and fluorine gas other than a fluorine respectively independently of the source of 2 gas By heating to the process which introduces inert gas alternatively from the source of the 3rd gas, mixes

gas, such as this, and forms mixed gas, and the temperature to which the aforementioned 1st halogen gas and the aforementioned fluorine gas react to a pyrogenetic-reaction machine through the aforementioned mixed gas. It is characterized by providing the process which supplies the aforementioned generation gas to the aforementioned processing interior of a room, generating the generation gas containing the fluorine compound gas between halogens.

[0015] The 2nd film which becomes substantial exists from the matter with which the view of the octavus of this invention was chosen from the group which consists of SiO_2 , SiNx , TaOx , and a photoresist on the aforementioned processed object in the method of the 7th view, and the aforementioned etching method is characterized by being that which *****s the one aforementioned film alternatively to the 2nd film of the above.

[0016] The 9th view of this invention *****s the 1st film which becomes substantial from the matter chosen from the group which consists of Si on a processed object, SiPO_2 , Ta, and TaSix . the [the processing room in which it is the etching system of a semiconductor processing system, and the aforementioned processed object is held, and / the 1st and], while introducing the 1st halogen gas and fluorine gas other than a fluorine respectively independently of the source of 2 gas. By heating to the upper section which introduces inert gas alternatively from the source of the 3rd gas, mixes gas, such as this, and forms mixed gas, and the temperature to which the aforementioned 1st halogen gas and the aforementioned fluorine gas react to a pyrogenetic-reaction machine through the aforementioned mixed gas. It is characterized by providing the downstream which supplies the aforementioned generation gas to the aforementioned processing interior of a room, generating the generation gas containing the fluorine compound gas between halogens.

[0017]

[Embodiments of the Invention] Drawing 1 is the schematic diagram showing the cleaning equipment concerning the gestalt of operation of this invention from which the by-product deposited on the processing interior of a room of a semiconductor processing system is removed. This cleaning equipment 30 is connected to CVD system 10 for forming a silicon film on processed substrates, such as a semiconductor wafer and a LCD substrate.

[0018] CVD system 10 possesses the processing room 12 for containing a processed substrate. In the processing room 12, the installation base 14 for laying a processed substrate is arranged. While exhausting the interior, the exhaust air system 16 for setting it as a vacuum is connected to the lower part of the processing room 12, moreover -- the upper part of the processing room 12 -- SiH_4 etc. -- the supply system 18 for supplying a raw gas is connected.

[0019] In such CVD system 10, the by-product which makes Si a principal component accumulates on the wall of the processing room 12, or the wall of piping of the exhaust air system 16 as membrane formation processing is repeated. The cleaning equipment 30 concerning this invention is used in order to remove such a by-product.

[0020] the [for cleaning equipment 30 supplying chlorine (Cl_2) gas, fluorine (F_2) gas, and inert gas, respectively / the 1st, the 2nd, and] -- it has the sources 32, 34, and 36 of 3 gas. The source 32 of gas of chlorine gas consists of a bomb filled up with the liquefied gas. Since chlorine gas has high vapor pressure, it is comparatively easy to supply. On the other hand, the source 34 of gas of fluorine gas consists of a gas generator which generates fluorine gas by electrolysis. In addition, fluorine gas can also be supplied with a bomb as a high pressure gas.

[0021] Inert gas can function as dilution gas or carrier gas, and the inactive (inactive) gas of helium, argon, or nitrogen can be used for it. However, it is desirable to use gaseous helium with high thermal conductivity from a viewpoint which assists heating of the mixed gas mentioned later especially here. In addition, inert gas may not be used depending on processing, namely, inert gas will be introduced alternatively.

[0022] It reaches, and the chlorine gas from the sources 32, 34, and 36 of the 3rd gas, fluorine gas, and inert gas let MFC (mass-flow controller) 38a, 38b, and 38c pass, respectively, and the 1st, the 2nd, and where a flow rate is mutually controlled independently, they are introduced. Thus, in the piping section 42, the chlorine gas introduced independently, respectively, fluorine gas, and inert gas join, and are

mixed, and mixed gas is formed. Here, the volume ratio of the chlorine gas in mixed gas, fluorine gas, and inert gas is set as 10-90:10-90:0-90.

[0023] Thus, the pyrogenetic-reaction machine 44, for example, a heat exchanger, lets the formed mixed gas pass, and it is heated by 250 degrees C - 350 degrees C. Thereby, chlorine gas and fluorine gas react and it is ClF_3 . The generation gas containing chlorine-fluoride gas, such as gas, is generated. Next, ClF_3 . The generation gas which makes gas a principal component and contains other chlorine-fluoride gas (ClF , ClF_5 , etc.), a by-product, a unconverted gas, etc. is ClF_3 by the condenser 46. ClF_3 after being cooled to the room temperature grade which is not liquefied. It is taken out by the pressure which is the grade which is not liquefied.

[0024] The generation gas which came out of the condenser 46 has the analyzer 48 which measures the fluorine compound between halogens let it pass first. The measurement result obtained by the analyzer 48 is fed back to the main controller 52, and MFC 38a, 38b, and 38c is controlled based on this. Thereby, it is adjusted so that the volume ratio of the chlorine gas in mixed gas, fluorine gas, and inert gas may serve as a predetermined value.

[0025] Next, in the buffer section 54, after generation gas has a flow rate and a pressure adjusted so that the conditions of the processing room 12 of CVD system 10 may be suited, it is supplied in the processing room 12. ClF_3 in the generation gas supplied in the processing room 12 Chlorine-fluoride gas, such as gas, reacts with the by-product which makes a principal component Si deposited on the wall of the processing room 12, or the wall of piping of the exhaust air system 16, and makes this exfoliate from a wall. The by-product which exfoliated is in the exhaust stream by the operation of the exhaust air system 16, and is discharged out of CVD system 10.

[0026] In addition, although cleaning equipment 30 is combined with CVD system 10 of silicon with the form of this operation and it is shown, chlorine-fluoride gas is effective when removing matter other than silicon (contest polysilicon and an amorphous silicon are included). Specifically, matter other than silicon here is Mo, Ta, W, SiO_x , SiN_x , SiC, SiGe, TaSix, TaOx, WSix, TiC, TiN, TiW, BN, ITO (indium tin oxide), etc. Therefore, cleaning equipment 30 is applicable effective in cleaning of a CVD system, an etching system, etc. by which the by-product containing the matter chosen from the group which consists of matter enumerated upwards by original processing is generated.

[0027] The mixed gas which consists of [experiment] chlorine gas 30SCCM, fluorine gas 100SCCM, and gaseous helium 100SCCM is formed, and it continued passing continuously by system internal pressure 836Torr in the pyrogenetic-reaction vessel 44 which consists of a heat exchanger made from nickel heated at 250 degrees C - 350 degrees C. Consequently, it is ClF_3 near the outlet of the pyrogenetic-reaction machine 44. Concentration is 10% - 30% and ClF_3 . It became clear that the generation gas whose yield is 60% - 80% is obtained.

[0028] Drawing 2 is the schematic diagram concerning the form of another operation of this invention showing the etching system of a semiconductor processing system. It sets on processed substrates, such as for example, a semiconductor wafer and a LCD substrate, and this etching system 60 is Si film SiO_2 . It is used in order to etch preferentially to a film (selective etching).

[0029] An etching system 60 possesses the processing room 62 for containing a processed substrate. In the processing room 62, the installation base 64 for laying a processed substrate is arranged. While exhausting the interior, the exhaust air system 66 for setting it as a vacuum is connected to the lower part of the processing room 62. Moreover, the supply system 70 for supplying etching gas is connected to the upper part of the processing room 62. The supply system 70 of an etching system 60 has the same composition as the cleaning equipment 30 of the drawing 1 illustration.

[0030] the [namely, / for the supply system 70 supplying chlorine (Cl_2) gas; fluorine (F_2) gas; and inert gas; respectively / the 1st, the 2nd and] it has the sources 72, 74, and 76 of 3 gas. It reaches, and the chlorine gas from the sources 72, 74, and 76 of the 3rd gas; fluorine gas; and inert gas let MFC (mass-flow controller) 78a, 78b, and 78c pass, respectively, and the 1st, the 2nd, and where a flow rate is mutually controlled independently, they are introduced. Thus, in the piping section 82, the chlorine gas introduced independently, respectively, fluorine gas, and inert gas join, and are mixed, and mixed gas is formed. Here, the volume ratio of the chlorine gas in mixed gas, fluorine gas, and inert gas is set as 10-

90:10-90:0-90.

[0031] Thus, the pyrogenetic-reaction machine 84, for example, a heat exchanger, lets the formed mixed gas pass, and it is heated by 250 degrees C - 350 degrees C. Thereby, chlorine gas and fluorine gas react and it is ClF_3 . The generation gas containing chlorine-fluoride gas, such as gas, is generated. Next, ClF_3 . The generation gas which makes gas a principal component and contains other chlorine-fluoride gas (ClF , ClF_5 , etc.), a by-product, a unconverted gas, etc. is ClF_3 by the condenser 86. ClF_3 after being cooled to the room temperature grade which is not liquefied. It is taken out by the pressure which is the grade which is not liquefied.

[0032] The generation gas which came out of the condenser 86 has the analyzer 88 which measures the fluorine compound between halogens let it pass first. The measurement result obtained by the analyzer 88 is fed back to the main controller 92, and MFC 78a, 78b, and 78c is controlled based on this. Thereby, it is adjusted so that the volume ratio of the chlorine gas in mixed gas, fluorine gas, and inert gas may serve as a predetermined value.

[0033] Next, in the buffer section 94, after generation gas has a flow rate and a pressure adjusted so that the conditions of the processing room 12 of CVD system 10 may be suited, it is supplied in the processing room 12. ClF_3 in the generation gas supplied in the processing room 62. It sets on a processed substrate and chlorine-fluoride gas, such as gas, is SiO_2 . Rather than a film, it reacts preferentially with Si film and this is *****ed. An etching product is in the exhaust stream by the operation of the exhaust air system 66, and is discharged out of an etching system 60.

[0034] In addition, at the form of this operation, an etching system 60 is the 1st film which consists of an Si film on a processed substrate SiO_2 . Although shown as equipment for carrying out selective etching to the 2nd film which consists of a film, chlorine-fluoride gas is Si film and SiO_2 . It is effective also in the selective etching of the combination of matter other than combination with a film. The 1st film with which it specifically *****s preferentially can do a bird clapper substantially from the matter chosen from the group which consists of Si, SIPOS (semi-insulating polycrystalline silicon), Ta, and TaSix. Moreover, the 2nd film with which it does not ***** preferentially can do a bird clapper substantially from the matter chosen from the group which consists of SiO_2 , SiN_x , TaO_x , and a photoresist.

[0035] In above-mentioned cleaning equipment 30 and an above-mentioned etching system 60, it is a user site, chlorine gas, fluorine gas, and inert gas are used as a source of gas, and it is ClF_3 . Chlorine-fluoride gas, such as gas, can be generated and supplied. Therefore, the problem on the operation in the case of providing a user site with chlorine-fluoride gas, such as ClF_3 gas, with a bomb as a liquefied gas and a mandatory control is solvable. Especially, according to the equipments 30 and 60, such as this, composition of generation gas can be adjusted according to processing by setting the volume ratio of the chlorine gas in mixed gas, fluorine gas, and inert gas as any value in the above-mentioned range, or setting the heating temperature of mixed gas as any value in the above-mentioned range.

[0036] Furthermore, it becomes possible by replacing with chlorine gas and using another halogen gas (except a fluorine) as gas of the source of the 1st gas (32 72), to generate and supply the fluorine compound gas between halogens another type. For example, as gas of the source 32 of the 1st gas, when bromine (Br_2) gas is used, they are BrF , BrF_3 , and BrF_5 . The generation gas containing at least one can be supplied. Moreover, as gas of the source 32 of the 1st gas, when iodine (I_2) gas is used, they are IF , IF_3 , IF_5 , and IF_7 . The generation gas containing at least one can be supplied.

[0037]

[Effect of the Invention] As explained above, it is on site, and since the generation gas which contains the fluorine compound gas between halogens by on demand one can be supplied, the cleaning method in a semiconductor processing system, equipment, the etching method and the safety of equipment, cost, flexibility, etc. are improvable according to this invention.

[Translation done.]

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2. **** shows the word which can not be translated.

3. In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] Si, Mo, Ta, W, SiO_x, SiN_x, SiC, SiGe, TaSix, TaO_x and WSix which were deposited on the processing interior of a room of a semiconductor processing system, the cleaning method of removing the by-product containing the matter chosen from the group which consists of TiC, TiN, TiW, BN, and ITO which are characterized by providing the following the [the 1st and] -- the process which introduces inert gas alternatively from the source of the 3rd gas, mixes gas, such as this, and forms mixed gas while introducing the 1st halogen gas and fluorine gas other than a fluorine respectively independently of the source of 2 gas. The process which supplies the aforementioned generation gas to the aforementioned processing interior of a room while generating the generation gas which contains the fluorine compound gas between halogens by heating to the temperature to which the aforementioned 1st halogen gas and the aforementioned fluorine gas react to a pyrogenetic-reaction machine through the aforementioned mixed gas

[Claim 2] The aforementioned 1st halogen gas in the aforementioned mixed gas, fluorine gas, and the cleaning method according to claim 1 characterized by setting the volume ratio of inert gas as 10-90:10-90:0-90

[Claim 3] It is the cleaning method according to claim 1 or 2 which the aforementioned 1st halogen gas is chlorine gas, and is characterized by the heating temperature of the aforementioned mixed gas with the aforementioned pyrogenetic-reaction machine being 250 degrees C - 350 degrees C.

[Claim 4] The aforementioned ***** is the cleaning method according to claim 1 to 3 characterized by being gaseous helium.

[Claim 5] Si, Mo, Ta, W, SiO_x, SiN_x, SiC, SiGe, TaSix, TaO_x and WSix which were deposited on the processing interior of a room of a semiconductor processing system, cleaning equipment from which the by-product containing the matter chosen from the group which consists of TiC, TiN, TiW, BN, and ITO is removed which are characterized by providing the following the [the 1st and] -- the upper section which introduces inert gas alternatively from the source of the 3rd gas, mixes gas, such as this, and forms mixed gas while introducing the 1st halogen gas and fluorine gas other than a fluorine respectively independently of the source of 2 gas. The downstream which supplies the aforementioned generation gas to the aforementioned processing interior of a room while generating the generation gas which contains the fluorine compound gas between halogens by heating to the temperature to which the aforementioned 1st halogen gas and the aforementioned fluorine gas react to a pyrogenetic-reaction machine through the aforementioned mixed gas

[Claim 6] The aforementioned upper section is cleaning equipment according to claim 5 characterized by providing the controller which changes the volume ratio of the aforementioned 1st halogen gas in the aforementioned mixed gas, fluorine gas, and inert gas by controlling independently mutually the flow rate of the aforementioned 1st halogen gas, fluorine gas, and inert gas.

[Claim 7] The etching method of the semiconductor processing system which *****s the 1st film which becomes substantial from the matter chosen from the group which consists of Si on a processed object, SIPOS, Ta, and TaSix characterized by providing the following the [the 1st and] -- the process

which introduces inert gas alternatively from the source of the 3rd gas, mixes gas, such as this, and forms mixed gas while introducing the 1st halogen gas and fluorine gas other than a fluorine respectively independently of the source of 2 gas. The process which supplies the aforementioned generation gas to the aforementioned processing interior of a room while generating the generation gas which contains the fluorine compound gas between halogens by heating to the temperature to which the aforementioned 1st halogen gas and the aforementioned fluorine gas react to a pyrogenetic-reaction machine through the aforementioned mixed gas

[Claim 8] It is the etching method according to claim 7 which the 2nd film which becomes substantial exists from the matter chosen from the group which consists of SiO_2 , SiNx , TaOx , and a photoresist on the aforementioned processed object, and is characterized by the aforementioned etching method being that which *****s the one aforementioned film alternatively to the 2nd film of the above.

[Claim 9] The etching system of the semiconductor processing system which *****s the 1st film which becomes substantial from the matter chosen from the group which consists of Si on a processed object, SIPOS, Ta, and TaSix characterized by providing the following The processing room in which the aforementioned processed object is held the [the 1st and], while introducing the 1st halogen gas and fluorine gas other than a fluorine respectively independently of the source of 2 gas By heating to the upper section which introduces inert gas alternatively from the source of the 3rd gas, mixes gas, such as this, and forms mixed gas; and the temperature to which the aforementioned 1st halogen gas and the aforementioned fluorine gas react to a pyrogenetic-reaction machine through the aforementioned mixed gas The downstream which supplies the aforementioned generation gas to the aforementioned processing interior of a room while generating the generation gas containing the fluorine compound gas between halogens

[Translation done.]